

各 位

2022 年 5 月 9 日

接合プロセス研究部門

微細接合学分野

第 1 回 微細接合学分野研究集会

【表面ナノ構造形成と固相接合への拡張】のご案内

日時：2022 年 6 月 17 日(金) 13：00～16：50

場所：大阪大学 接合科学研究所 2 階大会議室

主催：大阪大学接合科学研究所 微細接合学分野

趣旨：世界を牽引する日本のエレクトロニクス実装技術は、社会の変化をいち早く捉え、新たな社会の実現に向けて発展してきました。今回の研究集会では、低炭素社会の実現に不可欠な次世代パワーデバイスへの応用が期待される高耐熱微細接合技術や、IoT 社会の実現に不可欠なセンサーデバイスへの応用が期待される低温微細接合技術や三次元配線技術などに関するトピックスについて、計算科学と実験科学の両面から最新の研究開発事例をご講演頂きます。

プログラムを以下にご案内申し上げます。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

13：00-14：00	特別講演 動的モンテカルロ計算における有限温度モデルと 表面拡散系への適用	核融合科学研究所 伊藤 篤史 氏
14：00-14：40	原子層堆積法により形成した薄膜金属中間層を用いた 低温 Cu-Cu 疑似直接接合法の開発	早稲田大学 水野 潤 氏
14：40-14：50	休憩	
14：50-15：30	タングステン表面における原子拡散経路の 密度汎関数理論計算による評価	核融合科学研究所 高山 有道 氏
15：30-16：10	電気化学的手法を用いた Cu ナノ粒子の作製と 添加剤 PVP の挙動解析	早稲田大学 齋藤 美紀子 氏
16：10-16：50	表面ナノ構造を利用した接合部形成とその界面現象	大阪大学 西川 宏 氏

お申し込みは[こちらから](#)(6 月 16 日までにお申し込みください)